

2016-2022年中国LED封装市场深度研究与未来前景预测报告

报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

www.abaogao.com

一、报告报价

《2016-2022年中国LED封装市场深度研究与未来前景预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/dianzi/338477WSCJ.html>

报告价格：印刷版：RMB 9800 电子版：RMB 9800 印刷版+电子版：RMB 10000

智研数据研究中心

订购电话：400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真：010-60343813

Email：sales@abaogao.com

联系人：刘老师 谭老师 陈老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

国内LED封装产业在下游广阔的应用市场等因素带动下规模不断扩大，同时，近年来国际LED企业逐步向中国转移。内资封装企业在与各类外资封装企业竞争过程中技术不断成熟。目前国内企业主要集中在中低端封装领域，部分成熟企业在高端领域封装技术也有了较大突破。

随着工艺技术的不断完善和积累，国内LED封装企业在高端封装领域的市场份额逐步提高，竞争实力不断增强。

在良好的产业政策引导下，以及持续的技术创新，LED封装行业伴随LED产业快速增长。2012年，国内LED封装产值达到320亿元，较2011年增长12.3%；2013年，LED封装产值较上年增长25.9%，达到403亿元；封装规模约517亿元，较2013年增长了28%。

2014年，我国LED封装环节发展平稳，产值达517亿元，较2013年增长了28.3%。在产品规格上，2835、3030、5630等0.2~1W的中功率器件成为市场应用主流，其中管灯、球泡灯、面板灯、吸顶灯、天花灯等中小功率照明灯具所用光源70%以上为中功率封装器件，封装企业由以往的向大功率看齐，因应用需求导向，转而加大中功率器件的比重，今年中功率器件产量占比超过55%，而大功率器件占比不到15%，其余产品为0.2W以下的小功率器件。

2013年，我国LED封装年际产量为2897亿只，2014年行业产量增长至3750亿只，综合智研数据中心整理发布的行业规模数据，2014年我国封装产品均价为0.138元/只。随着全球LED行业的快速发展，LED封装技术不断趋于成熟，原材料成本逐渐下降，LED封装及应用产品价格随之不断下降。

《2016-2022年中国LED封装市场深度研究与未来前景预测报告》由智研数据研究中心公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、知识产权局、智研数据中心提供的最新行业运行数据为基础，验证于与我们建立联系的全国科研机构、行业协会组织的权威统计资料。

报告揭示了LED封装行业市场潜在需求与市场机会，报告对中国LED封装做了重点企业经营状况分析，并分析了中国LED封装行业发展前景预测。为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据。

报告目录：

第一章 LED封装相关概述

1.1 LED封装简介

- 1.1.1 LED封装的概念
- 1.1.2 LED封装的形式
- 1.1.3 LED封装的结构类型
- 1.1.4 LED封装的工艺流程
- 1.2 LED封装的常见要素
 - 1.2.1 LED引脚成形方法
 - 1.2.2 LED弯脚及切脚
 - 1.2.3 LED清洗
 - 1.2.4 LED过流保护
 - 1.2.5 LED焊接条件

第二章 2012-2015年LED封装产业总体发展分析

- 2.1 2012-2015年世界LED封装业的发展
 - 2.1.1 总体特征
 - 2.1.2 区域分布
 - 2.1.3 企业格局
- 2.2 2012-2015年中国LED封装业的发展
 - 2.2.1 发展现状
 - 2.2.2 产值增长情况
 - 2.2.3 产品结构分析
 - 2.2.4 产业链分析
 - 2.2.5 产能分析
 - 2.2.6 价格分析
- 2.3 2012-2015年国内重要LED封装项目进展
 - 2.3.1 欧司朗在华首个LED封装项目投产
 - 2.3.2 福建安溪引进LED封装线项目
 - 2.3.3 瑞丰光电扩产SMD LED项目
 - 2.3.4 徐州博润LED芯片封装项目开建
 - 2.3.5 晶圆级芯片封装项目落户淮安
 - 2.3.6 厦门信达增资扩建LED封装项目
- 2.4 SMD LED封装
 - 2.4.1 SMD LED封装市场发展简况

- 2.4.2 SMD LED封装技术壁垒较高
- 2.4.3 SMD LED封装产能尚未过剩
- 2.4.4 SMD LED封装受益于芯片价格下降
- 2.5 LED封装业发展中存在的问题
 - 2.5.1 制约我国LED封装业发展的因素
 - 2.5.2 国内LED封装企业面临的挑战
 - 2.5.3 传统封装工艺成为系统成本瓶颈
 - 2.5.4 封装企业选择不当发展模式
- 2.6 促进中国LED封装业发展的策略
 - 2.6.1 做大做强LED封装产业的对策
 - 2.6.2 发展LED封装行业的措施建议
 - 2.6.3 LED封装业发展需加大研发投入
 - 2.6.4 我国LED封装业应向高端转型

第三章 2012-2015年中国LED封装市场格局分析

- 3.1 2012-2015年LED封装市场发展态势
 - 3.1.1 LED封装市场运行特征
 - 3.1.2 LED封装市场需求结构
 - 3.1.3 LED封装企业规模扩大
 - 3.1.4 LED封装市场发展变局
 - 3.1.5 封装市场上下游战略合作
- 3.2 2012-2015年LED封装企业布局特征
 - 3.2.1 区域分布格局
 - 3.2.2 珠三角地区分布特点
 - 3.2.3 长三角地区分布特点
 - 3.2.4 其他地区分布特点
- 3.3 2012-2015年广东省LED封装业分析
 - 3.3.1 产业规模
 - 3.3.2 主要特点
 - 3.3.3 重点市场
 - 3.3.4 发展趋势
- 3.4 2012-2015年LED封装市场竞争格局

- 3.4.1 LED封装市场竞争加剧
- 3.4.2 LED封装市场竞争主体
- 3.4.3 台湾厂商扩大封装产能
- 3.4.4 本土企业布局背光封装
- 3.4.5 封装企业竞争焦点分析
- 3.5 2012-2015年LED封装企业竞争力简析
 - 3.5.1 2012年LED照明白光封装企业竞争力排名
 - 3.5.2 2013年LED照明白光封装企业竞争力排名
 - 3.5.3 2013年本土LED封装企业竞争力排名
 - 3.5.4 2014年本土COB封装企业竞争力排名

第四章 2012-2015年LED封装行业技术研发进展

- 4.1 中外LED封装技术的差异
 - 4.1.1 封装生产及测试设备差异
 - 4.1.2 LED芯片差异
 - 4.1.3 封装辅助材料差异
 - 4.1.4 封装设计差异
 - 4.1.5 封装工艺差异
 - 4.1.6 LED器件性能差异
- 4.2 2012-2015年中国LED封装技术研发分析
 - 4.2.1 封装技术影响LED光源发光效率
 - 4.2.2 LED封装专利申请状况
 - 4.2.3 LED封装行业技术特点
 - 4.2.4 LED封装技术创新进展
 - 4.2.5 LED封装技术壁垒分析
 - 4.2.6 LED封装业技术研发仍需加强
- 4.3 LED封装关键技术介绍
 - 4.3.1 大功率LED封装的关键技术
 - 4.3.2 显示屏用LED封装的技术要求
 - 4.3.3 固态照明对LED封装的技术要求

第五章 2012-2015年LED封装设备及封装材料的发展

- 5.1 2012-2015年LED封装设备市场分析
 - 5.1.1 LED封装设备需求特点
 - 5.1.2 LED封装设备市场格局
 - 5.1.3 LED封装设备国产化提速
 - 5.1.4 LED前端封装设备竞争加剧
 - 5.1.5 LED后端封装设备市场态势
 - 5.1.6 LED封装设备市场发展方向
 - 5.1.7 LED封装设备市场规模预测
- 5.2 LED封装的主要材料介绍
 - 5.2.1 LED芯片
 - 5.2.2 荧光粉
 - 5.2.3 散热基板
 - 5.2.4 热界面材料
- 5.3 2012-2015年中国LED封装材料市场分析
 - 5.3.1 LED封装材料市场现状
 - 5.3.2 2014年LED芯片产能分析
 - 5.3.3 2014年LED荧光粉价格走势
 - 5.3.4 LED封装辅料市场面临洗牌
 - 5.3.5 LED封装环氧树脂市场潜力巨大
 - 5.3.6 LED封装用基板材料市场走向分析
- 5.4 2012-2015年LED封装支架市场分析
 - 5.4.1 LED封装支架市场发展规模
 - 5.4.2 LED封装支架市场竞争格局
 - 5.4.3 LED封装支架市场技术路线
 - 5.4.4 LED封装PCT支架市场前景
 - 5.4.5 LED封装支架技术发展趋势

第六章 2012-2015年国内外重点LED封装企业分析

- 6.1 国外主要LED封装重点企业
 - 6.1.1 日亚化学 (NICHIA)
 - 6.1.2 欧司朗(OSRAM GmbH)
 - 6.1.3 三星电子 (SAMSUNG ELECTRONICS)

- 6.1.4 首尔半导体 (SSC)
- 6.1.5 科锐 (CREE)
- 6.2 台湾主要LED封装重点企业
 - 6.2.1 亿光电子
 - 6.2.2 隆达电子
 - 6.2.3 光宝集团
 - 6.2.4 东贝光电
 - 6.2.5 宏齐科技
 - 6.2.6 佰鸿股份
- 6.3 内地主要LED封装重点企业
 - 6.3.1 鸿利光电 (zyyzg)
 - 6.3.2 瑞丰光电
 - 6.3.3 长方照明
 - 6.3.4 国星光电
 - 6.3.5 木林森
 - 6.3.6 杭科光电
 - 6.3.7 晶台股份

第七章 中国LED封装产业发展趋势及前景

- 7.1 LED封装产业未来发展趋势
 - 7.1.1 功率型白光LED封装技术趋势
 - 7.1.2 无金线封装成LED封装新走向
 - 7.1.3 LED封装产业未来发展方向
- 7.2 中国LED封装市场前景展望
 - 7.2.1 我国LED封装市场发展前景乐观
 - 7.2.2 LED封装产品应用市场将持续扩张
 - 7.2.3 中国LED通用照明封装市场前景预测

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/dianzi/338477WSCJ.html>